IoT 時代における 2.1/2.5/3D 実装マーケットの展望

西尾　俊彦 *

2.1/2.5/3D Packaging Technology Market View in the Era of IoT

Toshihiko NISHIO*

* エスビーアールテクノロジー（〒 107-0062　東京都港区南青山 2-2-15　ウイン青山 9 階）
* SBR Technology (Win Aoyama 9F, 2-2-15, Minami-Aoyama, Minato-ku, Tokyo 107-0062)